

Descrizione del prodotto

Finitura: questa scheda deve essere placcata in oro a immersione secondo IPC-6012. Spessore deve essere .050uM oltre 3-6uM nichel.

Fori di rame piastra minima .025 AVG,. 020 min.. I fori non possono essere collegati

Imballi con la pellicola trasparente incolore della bolla, 25 pc/sacchetto, dissecante messo nel fianco, metta la scheda dell'indicatore di umidità sul lato superiore

Struttura del layer

L1-----Hoz

-PP 0.234 mm-

--

L2-----1

-COré 0.127 mm-

L3-----1

--

-PP 0.234 mm-

L4-----Hoz

Produttore: [HDI PCB stampato circuito di bordo](#), [Circuito stampato Fornitore](#), [Quick Turn PCB stampato circuito di bordo](#)



